

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS 、 BOYU CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED、COREVIEW CAPITAL MANAGEMENT LIMITED 、 DYMON ASIA CAPITAL LTD、 FENGHE FUND MANAGEMENT PTE LTD、 FOUNTAINCAP RESEARCH & INVESTMENT CO LTD、 FULLERTON FUND MANAGEMENT、 GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 、 GRAND ALLIANCE ASSET MANAGEMENT LIMITED 、 GREEN COURT CAPITAL MANAGEMENT LIMITED、 MILLENNIUM PARTNERS、 NEUBERGER BERMAN ASIA LIMITED、 PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED 、 PLEIAD INVESTMENT ADVISORS LIMITED、 POINT72 ASSET MANAGEMENT LP、 POLYMER CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED、 SB SCHONFELD FUND ADVISORS LLC 、 SUMITOMO MITSUIDS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED、 UBS O'CONNOR
时间	2025年1月
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理李大林先生

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、目前半导体及封测行业处于什么周期？</p> <p>2022年下半年至2023年第三季度，半导体行业处于去库存状态，随着去库存周期结束，2024年许多客户业绩高速增长，公司2024年营收也逐季度增加。目前去库存周期已经结束，处于正常状态，随着AI迅速发展，未来半导体下游应用场景在不断拓宽，对半导体产业链的需求也存在较大的提升空间。</p> <p>2、海内外客户结构情况？</p> <p>目前公司以国内SoC类客户以及IoT领域的客户为主；海外客户方面，2024年海外客户营收占比提升明显，有两家中国台湾地区头部设计公司已经进入公司主要客户群体。整体而言，随着公司规模不断提升以及先进封装产能的释放，公司有能力、有信心服务好国内SoC客户和全球头部设计公司。</p> <p>3、公司目前客户结构是怎样的？</p> <p>目前IoT客户占比约60%，PA客户占比约15%，安防类客户占比约15%，运算类和车规类产品及其他产品占比约10%。</p> <p>4、Q4营收增长但利润未体现出来的原因？</p> <p>公司今年下半年的固定资产新增以及折旧金额有所增加，对毛利率有所影响；相信随着公司营收规模的增长，规模效应逐渐体现，对毛利率及期间费用率均有正向促进。</p> <p>5、公司稼动率情况？</p> <p>公司稼动率处于相对饱满的状态。一期以成熟封装产品为主，稼动率持续维持高位，二期以先进封装产品为主，产能持续爬坡。</p> <p>6、资本开支主要投向封装还是测试？</p> <p>公司采取封装驱动测试的策略，为客户提供“Bumping+CP+FC+FT”的一站式大turnkey方案，未来资本</p>
----------------------	---

	<p>开支以封装为主，测试会与封装的投资节奏相匹配。2025 年将重点投资先进封装的相关设备。</p> <p>7、未来两年的营收预期？</p> <p>公司努力达成公司股权激励设置的营收目标。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 1 月 24 日